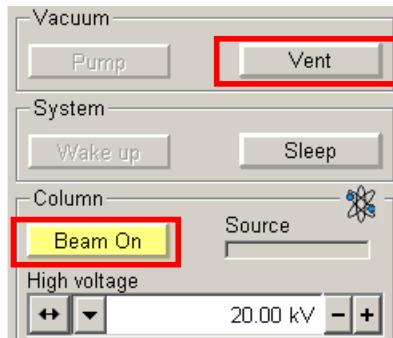


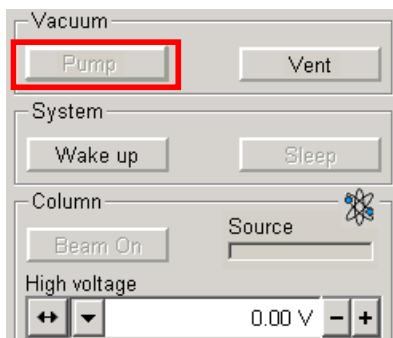
NOVA 600 操作流程

1) 試片的置放

程序:a) i)關閉 E beam/I beam, ii)按 Vent



b) i)拉開 chamber door 並置入樣品, ii)按 Pump



c) 確認真空度達約 10^{-5} mbar



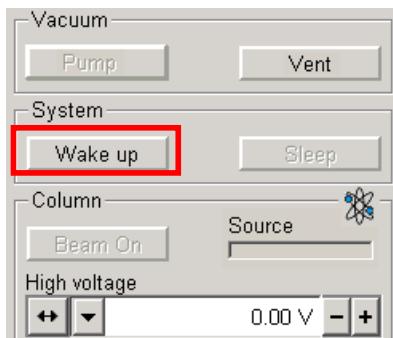
完成



未完成

2)電子束及離子束的 ON/OFF

程序:按 Wake up 以開啟 E beam/I beam



3) 試片/切割點的搜尋

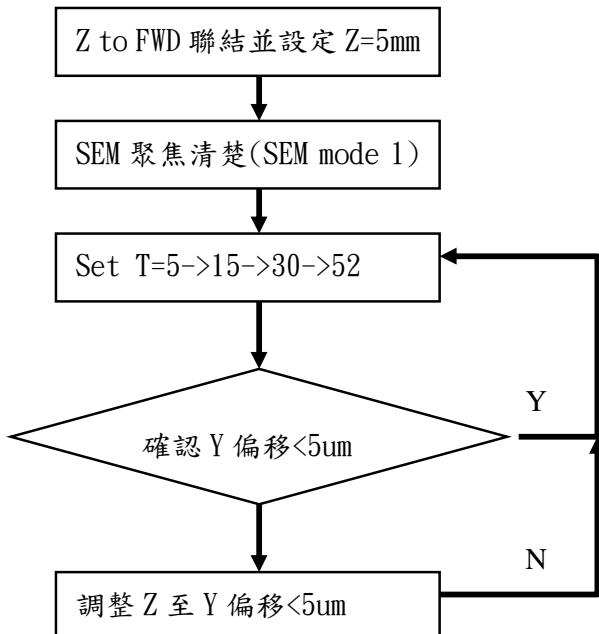
- 程序:a) 以低倍率 SEM(mode 1)聚焦並搜尋樣品
b) i) 執行 Z to FWD 的聯結, ii) 設定 Z=5mm (在 SEM mode)



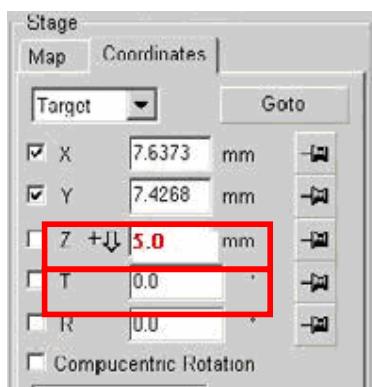
- c) 將倍率調至約 5000x(scal bar 顯示 5um), 並調聚焦(注意:stage 的移動必需配合滑鼠和 QUADE 1-3 in CCD camera screen)

4) 試片共焦點(Eucentric height)的設定(在 SEM mode)

程序:



- 注意:i) Z 軸的移動必需配合滑鼠和 QUADE 4 in CCD camera screen
ii) 5 軸座標參數設定



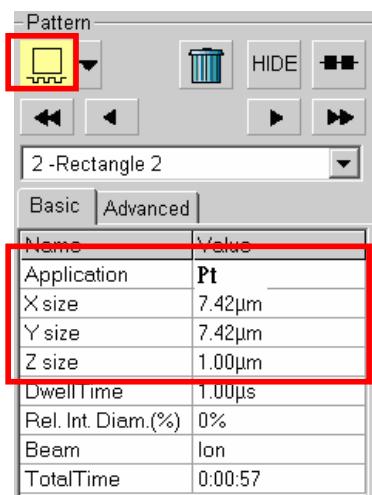
5) 試片的切割及鍍 Pt 保護層

程序: a) 切換至 FIB mode (beam current 選定 30~50pA)

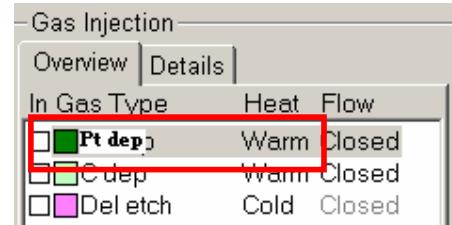
b) 選 patterning



c) i) 選定 patterns, 設定 xyz, ii) 選定 material file, iii) 選定適當的 I beam currents.



d) 加熱 Pt 及伸針

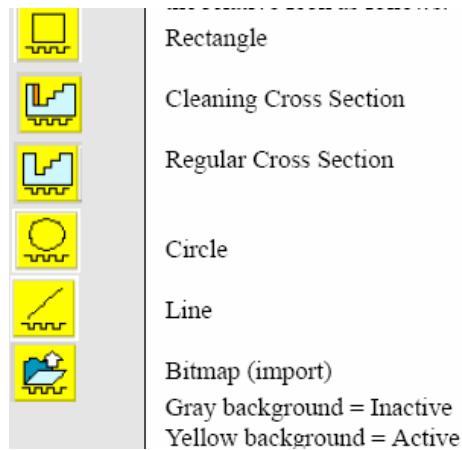


e) 執行 patterning



c) 執行 X-section

選定 regular cross section-> cleaning cross section



6) 取影像及儲存影像(切換至 SEM mode)



即時影像



取單張影像

F2 為 photo